**2023年度苏州工业园区集成电路产业发展专项资金申报书**

（2.1 支持企业融资）

一、项目基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | | | |
| 社会信用代码 | |  | | | | |
| 单位地址 | |  | | | | |
| 法定代表人 | |  | | 联系电话 |  | |
| 联系人 | |  | | 联系电话 |  | |
| 注册时间 | |  | | 注册资本  （万元） |  | |
| “6+2”发展方向 | | 六大主赛道：  集成电路芯片设计 高端制造  先进封测 关键设备  核心材料 自主软件  两大特色领域：  微机电系统（MEMS）  第三代半导体 | | | | |
| 企业介绍及主营业务概述（300字以内） | |  | | | | |
| 财务发展情况 | 指标/年份 | | | 2021年 | | 2022年 |
| 营业收入（万元） | | |  | |  |
| 专利数量（个） | | |  | |  |
| 首轮融资总额（万元） | | |  | | | |
| 首轮融资机构实缴金额（万元） | | |  | | | |
| 首轮融资完成日期 | | |  | | | |
| 首轮机构投资方 | | |  | | | |
| 企业股权变更登记记录（从注册开始） | | | 时间、股东、比例、注册资本变化情况等 | | | |
| 下一轮融资计划 | | |  | | | |

二、企业及项目介绍

包括企业团队构成、技术产品能力、未来发展计划等。

三、首轮融资知名股权机构简介（及入选榜单证明材料）